

# 通富微电子股份有限公司

## 首次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

#### (一) 2020 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1488 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 175,332,356 股，发行价为每股人民币 18.66 元，募集资金总额为人民币 3,271,701,762.96 元。扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费 100 万元）人民币 23,893,614.10 元后的募集资金为人民币 3,247,808,148.86 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 28 日汇入本公司在中国建设银行南通崇川支行开立的 32050164273600002187 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用人民币 2,459,165.57 元后，本次发行（下称“2020 年非公开发行”）募集资金净额为人民币 3,245,348,983.29 元。

2020 年非公开发行募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2020）第 110ZC00405 号《验资报告》。

截至 2025 年 9 月 30 日，2020 年非公开发行开立的募集资金专户已全部注销完毕。

## (二) 2022年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]261号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，发行价为每股14.62元，募集资金总额为人民币2,692,999,921.02元。扣除承销费和保荐费人民币13,673,249.53元（含增值税）后的募集资金为人民币2,679,326,671.49元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的512902062410666号账户内1,310,000,000.00元，在中国建设银行南通崇川支行开立的32050164273600003056号账号内1,369,326,671.49元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,692,999,921.02元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用人民币14,627,782.31元（不含增值税）后，本次发行（下称“2022年非公开发行”）募集资金净额为人民币2,678,372,138.71元。

2022年非公开发行募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》。

截至2025年9月30日，2022年非公开发行的募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存储余额
------	------	------	------

南通通富	工商银行南通分行	1111822229100755187	
通富微电	建设银行(注)	32050164273600003056	已销户
通富微电	招商银行(注)	551905209810666	已销户
通富微电	中国银行南通分行	548278415101	162,686.82
通富微电	建设银行	32050164273600003170	13,522.69
通富微电	招商银行	512902062410558	11,766.15
通富通科	建设银行	32050164273600003169	91,365,201.23
通富通科	招商银行	513904958410566	112,301,492.75
<b>合计</b>			<b>203,854,669.64</b>

注：上述两个账户在募集资金项目变更时已经完成销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 2020年非公开发行

#### 1、2020年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

详见“附件1-1、2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

#### 2、2020年非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺存在差异的说明

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺募集资金投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
1	车载品智能封装测试中心建设	103,000.00	105,450.08	2,450.08	使用账户内产生的利息进行投资
2	集成电路封装测试二期工程	76,020.00	76,061.79	41.79	使用账户内产生的利息进行投资
3	高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00	50,186.63	186.63	使用账户内产生的利息进行投资
4	补充流动资金及偿还银行贷款	95,514.90	95,514.90		
<b>合计</b>		<b>324,534.90</b>	<b>327,213.40</b>	<b>2,678.50</b>	

## (二) 2022年非公开发行

### 1、2022年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

详见“附件 1-2、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

### 2、2022年非公开发行股票募集资金项目实际投资额与承诺存在差异的说明

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺募集资金投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
1	高性能计算产品封装测试产业化项目	46,000.00	46,886.47	886.47	使用账户内产生的利息进行投资
2	微控制器（MCU）产品封装测试项目	78,000.00	56,944.46	-21,055.54	尚未完成建设
3	功率器件产品封装测试项目	63,650.00	53,871.21	-9,778.79	尚未完成建设
4	补充流动资金及偿还银行贷款	80,187.21	80,187.21		
合计		267,837.21	237,889.35	-29,947.86	

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

#### (一) 2020年非公开发行

不存在。

#### (二) 2022年非公开发行

本公司 2023 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第二十次会议和 2023 年 1 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，将“5G 等新一代通信用产品封装测试项

目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为本公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。变更情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更用途的募 集资金金额 (万元)	变更金额占前 次募集资金净 额的比例%
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
5G 等新一代通 信用产品封装 测试项目	90,850.00	微 控 制 器 (MCU) 产 品 封 装 测 试 项 目	78,000.00	78,000.00	29.12
功率器件封装 测试扩产项目	50,800.00	功 率 器 件 产 品 封 装 测 试 项 目	63,650.00	63,650.00	23.76

本公司以该部分募集资金向通富通科增资及提供借款，用于本次变更后的募投项目。借款期限自实施借款之日起，至相关募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可滚动使用，也可提前偿还，借款利率不超过银行同期贷款利率，借款到期后，可视通富通科实际经营情况，继续借予通富通科滚动使用。

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

##### （一）2020年非公开发行

###### 1、对外转让情况

不存在。

###### 2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

经本公司 2020 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至 2020 年 10 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为 48,194.76 万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2020）第 110ZA09948 号报告予以验证。

### 3、对外转让或置换的收益情况

不存在。

### 4、置换进入资产的运行情况

不存在。

## （二）2022 年非公开发行

### 1、对外转让情况

不存在。

### 2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

经本公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对截至 2022 年 10 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为 9,847.52 万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2022）第 110A017033 号报告予以验证。

### 3、对外转让或置换的收益情况

不存在。

#### 4、置换进入资产的运行情况

不存在。

### 五、临时闲置募集资金情况

#### (一) 2020 年非公开发行

##### 1、闲置募集资金购买银行理财产品情况

经本公司 2020 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，可使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 28 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款存单等，在决议有效期内 28 亿元资金额度可滚动使用。同时董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

经本公司 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，可使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 16 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存

款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 **16** 亿元资金额度可滚动使用。同时董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至 **2025** 年 **9** 月 **30** 日，投资理财产品累计金额 **18.72** 亿元，已全部收回。

## 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （二）**2022** 年非公开发行

#### 1、闲置募集资金购买银行理财产品情况

经本公司 **2022** 年 **11** 月 **21** 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，可使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 **15** 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 **12** 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 **15** 亿元资金额度可滚动使用。同时董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

经本公司 2023 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，可使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 9 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 9 亿元资金额度可滚动使用。同时董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

经本公司 2025 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，可使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 4 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 4 亿元资金额度可滚动使用。同时董事会授权总裁在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至 2025 年 9 月 30 日，投资理财产品累计金额 32.80 亿元，已全部收回。

## 2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

### (一) 2020 年非公开发行

截至 2025 年 9 月 30 日，2020 年非公开发行募集资金已全部使用完毕，开立的专用账户已全部注销。

### (二) 2022 年非公开发行

截至 2025 年 9 月 30 日，2022 年非公开发行募集资金净额 267,837.21 万元，实际使用募集资金 237,889.35 万元，其中累计直接投入募投项目 157,702.14 万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款 80,187.21 万元。尚未使用的募集资金 20,385.47 万元（包含扣除手续费后的利息和理财收入 4,875.38 万元，未包括为募投项目开立信用证的保证金 14,437.77 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 7.61%。

尚未使用的原因：相关募投项目建设尚未完成。

剩余资金的使用计划和安排：剩余资金将继续投入募投项目，并按进度于 2025 年 12 月基本使用完毕。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 2020 年非公开发行

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2

## 2、效益的计算口径、计算方法

车载品智能封装测试中心建设项目、集成电路封装测试二期工程项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目均以净利润为实现效益的口径，其计算方法为项目产生的营业收入减去对应的营业成本、税金及附加、期间费用，并扣除所得税费用后，最终得出该募集资金投资项目的实际效益，实际效益与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金用于增强公司资金实力、满足业务发展需求、优化公司资本结构、降低财务风险，无法单独核算效益。

## 4、累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

车载品智能封装测试中心建设项目、集成电路封装测试二期工程项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目累计实现的收益低于承诺的累计收益，主要受项目投产初期 **2022** 至 **2023** 年全球半导体市场疲软、行业周期波动影响，消费电子市场持续低迷，上述终端客户采购量下降；此外，新产品存在市场开拓期，新产品封装测试工艺需要经历必要前期客户验证阶段，客户拓展需要逐步推进。

## （二）**2022** 年非公开发行

### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况

高性能计算产品封装测试产业化项目、微控制器（MCU）产品封装测试项目和功率器件产品封装测试项目均在建设期，尚未完工。

## 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金用于增强公司资金实力、满足业务发展需求、优化公司资本结构、降低财务风险，无法单独核算效益。

## 八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

### （一）2020年非公开发行

不存在。

### （二）2022年非公开发行

不存在。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如果存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

附件：1-1、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

通富微电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：通富微电子股份有限公司

截止日：2025 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额：			324,534.90			已累计使用募集资金总额：			327,213.40	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	车载品智能封装测试中心建设	车载品智能封装测试中心建设	103,000.00	103,000.00	105,450.08	103,000.00	103,000.00	105,450.08	2,450.08	2022 年 12 月
2	集成电路封装测试二期工程	集成电路封装测试二期工程	145,000.00	76,020.00	76,061.79	145,000.00	76,020.00	76,061.79	41.79	2022 年 6 月
3	高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00	50,000.00	50,186.63	50,000.00	50,000.00	50,186.63	186.63	2022 年 6 月
4	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	102,000.00	95,514.90	95,514.90	102,000.00	95,514.90	95,514.90		不适用
合计			400,000.00	324,534.90	327,213.40	400,000.00	324,534.90	327,213.40	2,678.50	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（一）、2.

公司法定代表人： 石磊

主管会计工作的公司负责人： 廖洪森

公司会计机构负责人： 陶翠红



附件 1-2:

首次募集资金使用情况对照表

编制单位：通富微电子股份有限公司

截止日：2025 年 9 月 30 日

单位：人民币万元

2、2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额：			267,837.21			已累计使用募集资金总额：			237,889.35	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工进度）
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	高性能计算产品封装测试产业化项目	高性能计算产品封装测试产业化项目	82,856.00	46,000.00	46,886.47	82,856.00	46,000.00	46,886.47	886.47	2025 年 12 月
2	5G 等新一代通信用产品封装测试项目	微控制器（MCU）产品封装测试项目	90,850.00	78,000.00	56,944.46	90,850.00	78,000.00	56,944.46	-21,055.54	2025 年 12 月
3	功率器件封装测试扩产项目	功率器件产品封装测试项目	50,800.00	63,650.00	53,871.21	50,800.00	63,650.00	53,871.21	-9,778.79	2025 年 12 月
4	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	165,000.00	80,187.21	80,187.21	165,000.00	80,187.21	80,187.21		不适用
合计			389,506.00	267,837.21	237,889.35	389,506.00	267,837.21	237,889.35	-29,947.86	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“首次募集资金使用情况报告”二、（二）、2。

公司法定代表人：石磊

主管会计工作的公司负责人：廖洪森

公司会计机构负责人：陶翠红

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 通富微电子股份有限公司

截止日: 2025 年 9 月 30 日

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率 (注 1)	承诺效益	实际效益						截止日累 计实现效 益	是否 达到 预计 效益	备注	
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月				
2020 年度非公开发行													
1	车载品智能封装测试中心建设	103.58%	年税后利润 7,851 万元	--	--	--	3,795.70	7,280.57	5,373.18	16,449.45	否	注 2	
2	集成电路封装测试二期工程	58.36%	年所得税后利润 20,433 万元	--	--	1,254.15	2,152.18	13,398.19	12,670.76	29,475.28	否	注 2	
3	高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	79.21%	年税后利润 13,906 万元	--	--	3,592.55	5,181.06	12,642.34	9,746.64	31,162.59	否	注 2	
4	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不直接产生经济效益	

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2: 车载品智能封装测试中心建设项目、集成电路封装测试二期工程项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目累计实现的收益低于承诺的累计收益, 主要受项目投产初期 2022 至 2023 年全球半导体市场疲软、行业周期波动影响, 消费电子市场持续低迷, 上述终端客户采购量下降; 此外, 新产品存在市场开拓期, 新产品封装测试工艺需要经历必要前期客户验证阶段, 客户拓展需要逐步推进。

公司法定代表人: 石磊

主管会计工作的公司负责人: 廖洪森

公司会计机构负责人: 陶翠红